

お取引先様 各位

PCN20-SM2003-2  
2020年11月25日  
富士通セミコンダクターメモリソリューション株式会社  
品質保証部  
部長 井上 憲一



## 後工程（組み立て、最終試験）工場変更について（通知）

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、貴社にご採用いただいております製品につきまして、後工程工場を変更することに至りました。

変更内容は下記の通りとなりますので、ご理解のほどよろしくお願いたします。

なお本件につきまして何かご不明な点がございましたら、弊社担当営業までお問い合わせくださいますよう、よろしくお願いたします。

敬 具

- 記 -

### 1. 貴社対象品

- ・MB85RXXXXPNF-G-JNERE1
- ・MB85RXXXXPNF-G-JNE1

### 2. 移管内容

通富微電子 150mil SOP8 パッケージの後工程工場(組み立て、最終試験)を南通工場から合肥工場へ移管します。

### 3. 変更理由

現行、後工程を委託している通富微電子 南通工場の SOP8 ライン縮小に伴い同社の合肥工場への移管し、製造を継続する為です。

### 4. 依頼事項

- ・本品種の組み立て工場移管に伴い、従来品の最終所要を取りまとめの上、発注をお願い致します。
- ・下記の最終オーダーまでに発注をお願い致します。それ以降のオーダーは合肥工場移管品になります。

MB85RC16/MB85RC64 以外

南通工場品最終オーダー日：2021年1月29日

南通工場品最終出荷日：2021年5月28日

MB85RC16/MB85RC64

南通工場品最終オーダー日：2021年4月28日

南通工場品最終出荷日：2021年12月24日

最終オーダー日までに回答がない場合は切り替えに合意いただいたものとさせていただきます。

## 5 . 移管後の製品について

- ・ 弊社型格は南通工場のもと同じで変更ありません。
- ・ 出荷スケジュール：信頼性評価：2020年1月29日に終了、MP：2021年6月から開始  
評価サンプルは2020年12月18日迄に必要な数の連絡をお願いします  
(10個/型格以内でお願いいたします)
- ・ 主要変化点： 後工程製造委託先工場：通富微電子：南通工場から合肥工場へ移管  
樹脂：ハロゲン含有樹脂 ハロゲンフリー樹脂(グリーン環境対応)  
Lead 外装メッキ材料：SnBi Pure Sn  
パッケージの外形の変更はありません。  
その他の詳細な変更点は“PCN\_通富微電子 SOP8 合肥移管\_説明資料”をご覧ください

以上